产品特点：

K-5211H 导热硅脂采用进口原料和配方生产，使用导热性和绝缘性良好的金属氧化物与有机硅氧烷复合而成的膏脂状物,。产品具有极佳的导热性，良好的电绝缘性，较宽的使用温度（工作温度-50℃～+200℃），比 **K-5211** 具有更高的触变性和良好的立面施工性能及更优的使用稳定性。本品无毒、无腐蚀、无味、不干、不溶解。

用途：

广泛用于电子、电器、元器件的散热，填充或涂覆，以导出元器件产生的热量。如 CPU 与散热器填隙、大功率三极管、可控硅元件、二极管与基材（铝、铜）接触的逢隙处的填充、视机功放管及散热片之间、半导体制冷等。降低发热元件的工作温度。

技术性能：

性能名称	测试值	备注
外观	白色膏状物	目测
锥入度（1/10mm，25℃）	260～300	GB/T269
比重（g/cm3）	2.1～2.3	ASTM D1475
油离度（%。200℃，24h）	≤2.0	
挥发份（%。200℃，24h）	≤2.0	
击穿电压强度（kv/mm）	≥10	GB1695-2005
体积电阻率（Ω.cm）	$\geq 4\times10^{14}$	GB/T1692-2008
导热系数（w/m k）	1.2±0.3	ASTM D5470

使用方法：

清洗待覆表面，除去油污，然后将导热硅脂直接挤出，均匀的涂覆要待涂覆表面即可。涂覆方式可根据需要采用刷涂、刮涂或滚涂。

注意事项：

施工表面应该均匀一致，涂覆时并不是涂的越多越好，而是在保证填满面间隙的前提下，涂覆薄薄一层即可。

包装规格： 1.0kg/罐、100g/支、300ml/支，也可根据用户需要商定。

贮存： 贮存于 30℃以下阴凉干燥处，贮存期为 12 个月。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。